

# 2010年3月期 事業環境と業績予想

代表取締役社長 竹中 博司

2009年5月14日



東京エレクトロン

# はじめに

- ▶ 半導体やFPDの市場は今後も3次元で拡大
  - 地域：先進国から人口の多いアジア、新興国へ
  - アプリケーション：携帯モバイルから医療・通信等の社会インフラへ
  - 性能：より高速、大容量、低消費電力へ
- ▶ エレクトロニクス製品の技術革新を支え、発展を実現する製造装置産業は、今後もアップダウンを繰り返しながらも成長を継続

TELは、約半世紀に亘る製造装置ビジネスの中で、卓越した技術開発力と顧客からの絶対的信頼を構築  
今後もこの総合力を生かしてビジネスを拡大



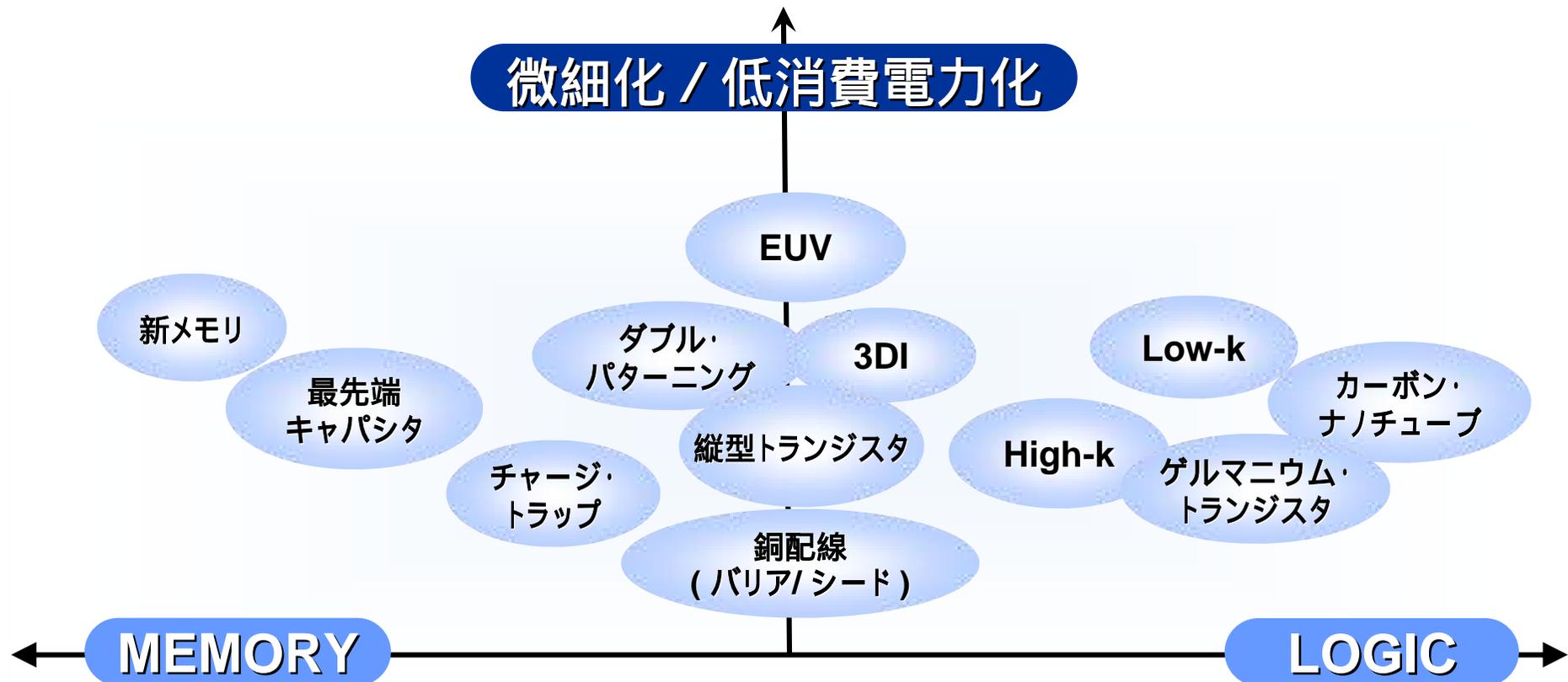
# 変化するSPE事業環境

- プロセス技術： 微細化、低消費電力化
- 顧客： 寡占化が加速
- 装置市場： アジアシフト
- 装置： 量産性追求、環境対応
- ポストセールス： 装置のロングライフ化

市場の変化を総点検して、ポジションを向上



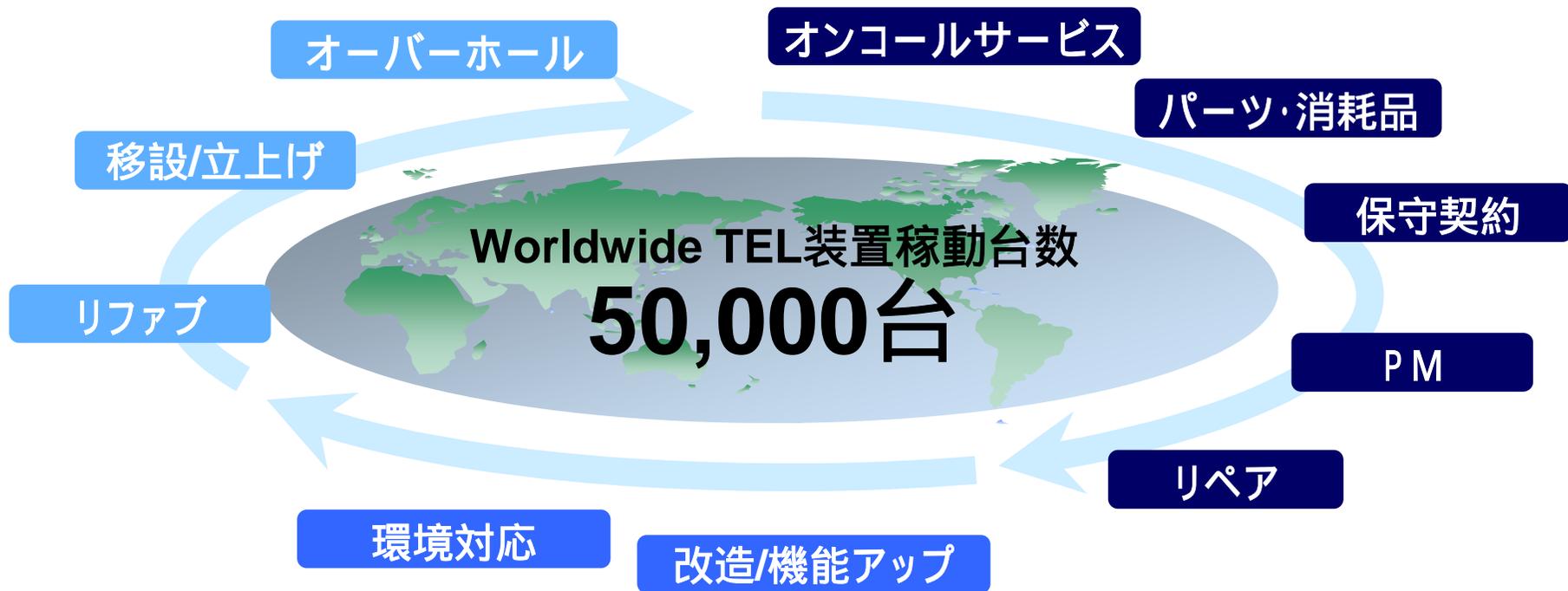
# SPEの技術革新はこれからも継続



微細化、低消費電力の追求はこれからが本番



# ポストセールス事業を強化



事業発掘と、装置のロングライフ化への対応



# 太陽電池製造装置事業を強化

## TELの事業展開

---

**SHARP**

### シャープとの共同開発

- 薄膜シリコン太陽電池プラズマCVD装置
  - TEL: 共同開発・製造・販売
- 

**oerlikon**  
solar

### Oerlikon Solar(エリコン・ソーラー)との提携

- 薄膜シリコン太陽電池一貫製造ライン
  - TEL: アジア、オセアニアにおける販売代理店
- 

  
TOKYO ELECTRON

### TEL独自開発

## 太陽電池製造装置事業を3本目の柱に



# 2009年3月期 総括



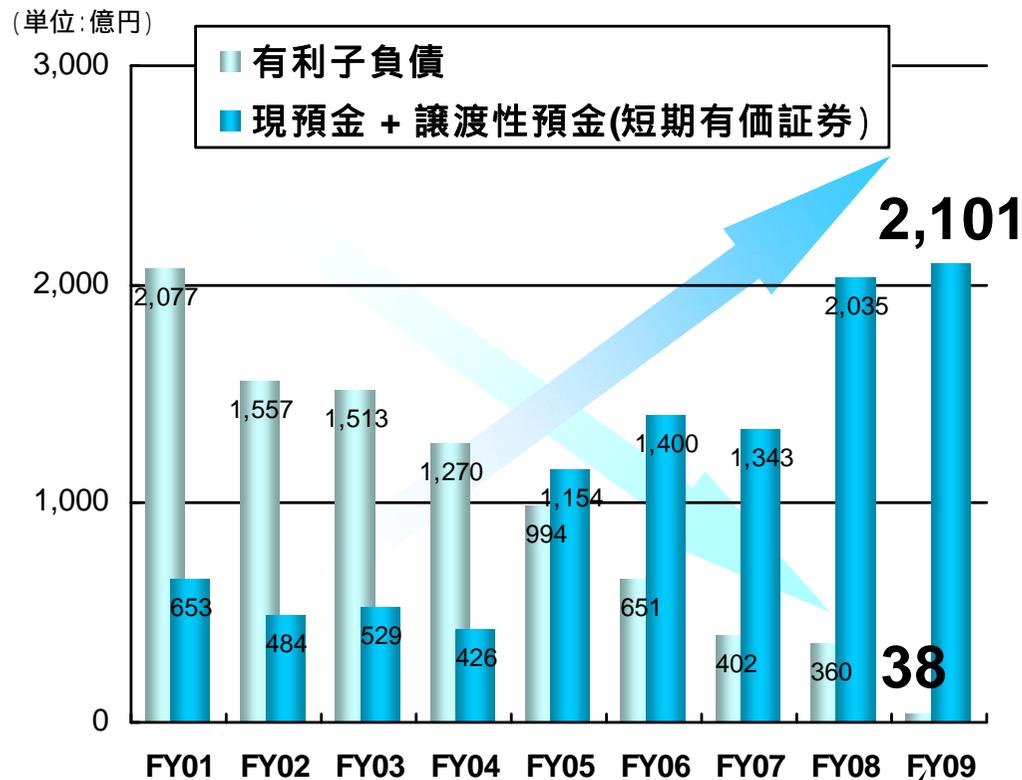
# 2009年3月期 総括

- ▶ **急激な市場変化への早急な対応で、黒字を確保**
  - ・ 前年比400億円の固定費削減
- ▶ **強いバランス・シートを維持**
  - ・ 営業キャッシュ・フロー 810億円
  - ・ 期末キャッシュ残高\* 2,101億円 D/Eレシオ 0.7%
- ▶ **継続的な研究開発投資と新製品創出**
  - ・ 研究開発費609億円
  - ・ SPE新モデルおよび第10世代FPD製造装置を市場投入
  - ・ 量産向けダブル・パターンング技術の確立
- ▶ **PV事業における進展**
  - ・ Oerlikon Solar社との戦略的提携締結



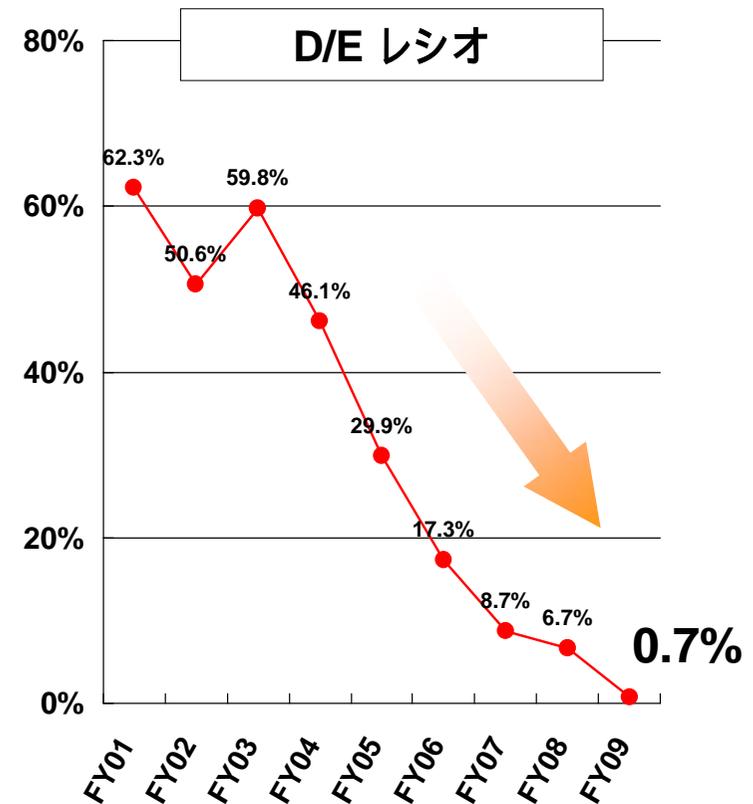
\* 現預金 + 譲渡性預金(短期有価証券)の残高

# 強いバランスシートを維持



ネット・デット 1,073億円

ネット・キャッシュ 2,063億円



# 2008年 新製品

Coater / Developer  
**CLEAN TRACK®**  
**LITHIUS Pro® V**



Single Wafer Deposition  
**Trias® SPAi**



Scrubber System  
**NS300+**



Wafer Prober  
**Precio octo®**



Wafer Prober  
**WDF® 12DP**



MEMS Tester  
**TEMEON™-C**



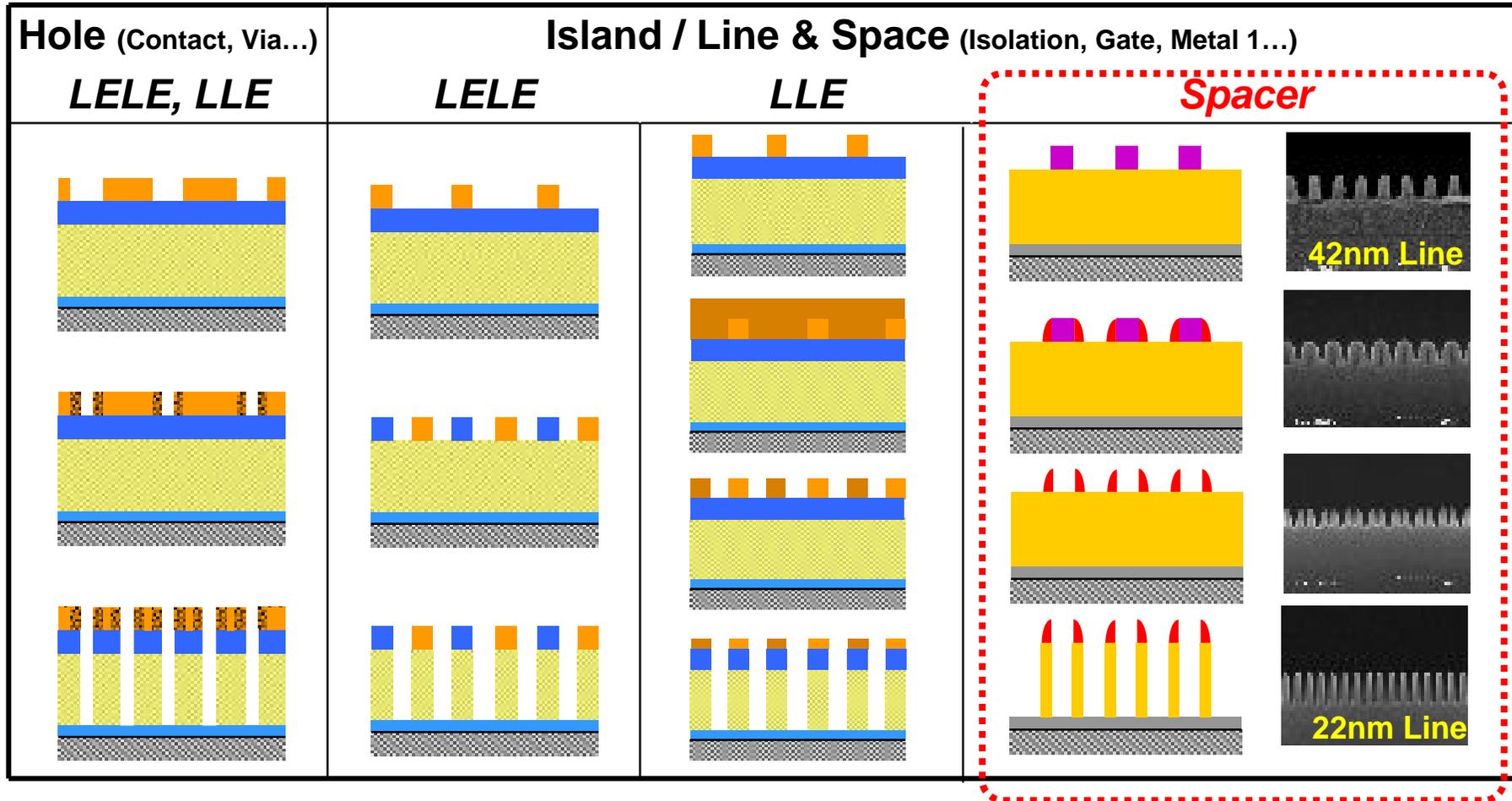
PFC除害装置  
**PA-01T**



キーワードは「高生産性」「環境対応」



# TELが取り組むダブルパターンニング技術



# Oerlikon Solarとの戦略的提携

薄膜シリコン太陽電池一貫製造ラインの独占販売代理店(販売、立上げ、顧客サポート)

テリトリー：日本を含むアジア及びオセアニア

**oerlikon**  
solar

薄膜シリコン太陽電池一貫製造  
ラインの出荷実績世界ナンバー  
ワン



TOKYO ELECTRON

SPE/FPDで培われた技術力、及び  
保守サポート力/営業力に対する  
信頼感

市場急成長が期待されるアジアでのビジネス拡大



# 事業環境



# 2010年3月期の事業環境

## ▶ 半導体設備投資

引き続き厳しい受注環境が続くが、複数の微細化投資案件あり

- NAND: スマートフォン向けに需要旺盛、30nm微細化投資開始
- DRAM: 主要各社から50nm微細化投資開始
- LOGIC/ファンダリ: 在庫調整が進み、45nm/32nm向け投資再開

## ▶ FPD設備投資

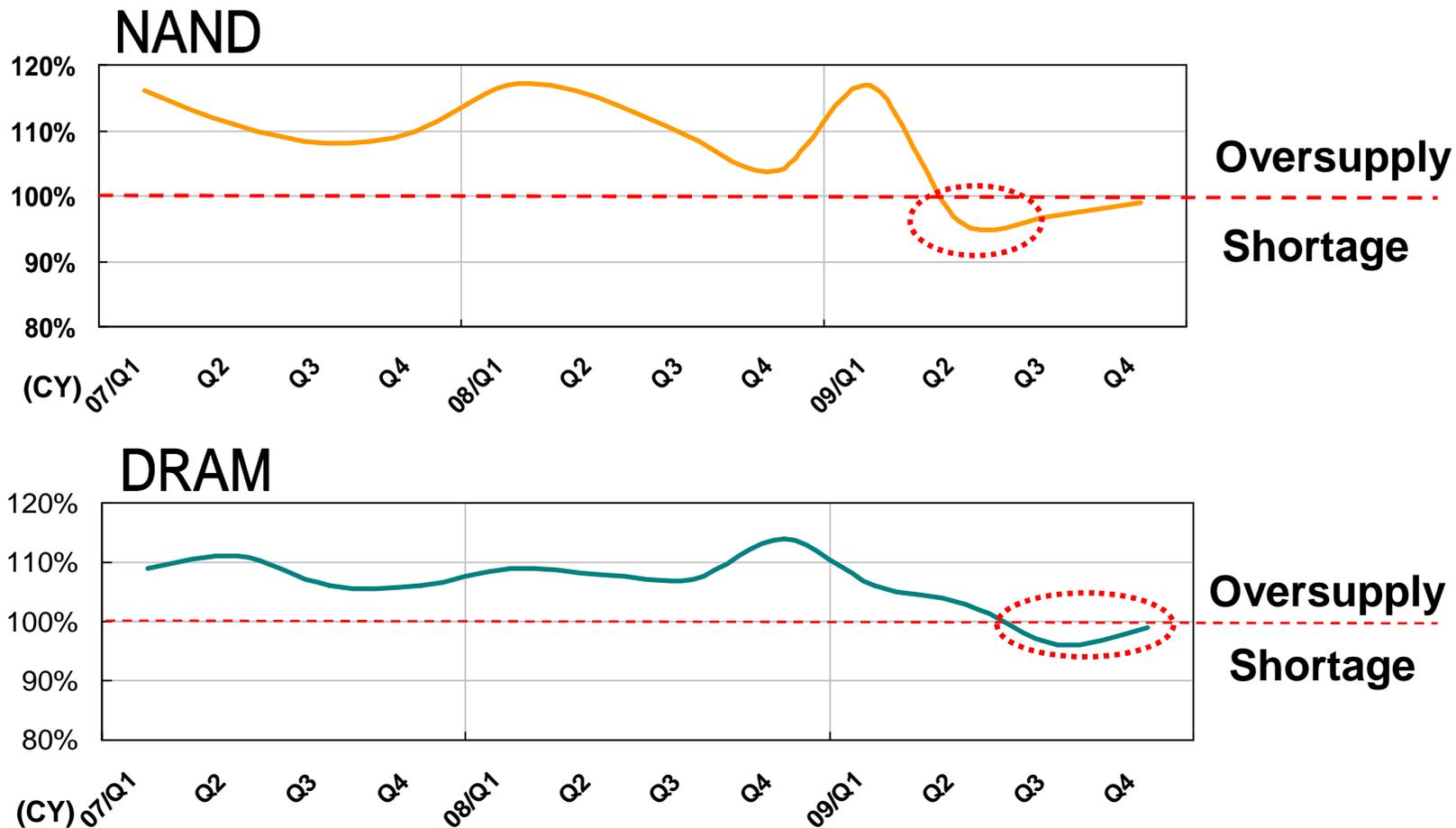
中国向けTV需要により生産は底打ちしつつあるが、スローな回復を見込む

## ▶ PV設備投資

世界経済悪化と政府援助システムのトーンダウンにて少し減速しているが、将来的には大きな成長を期待



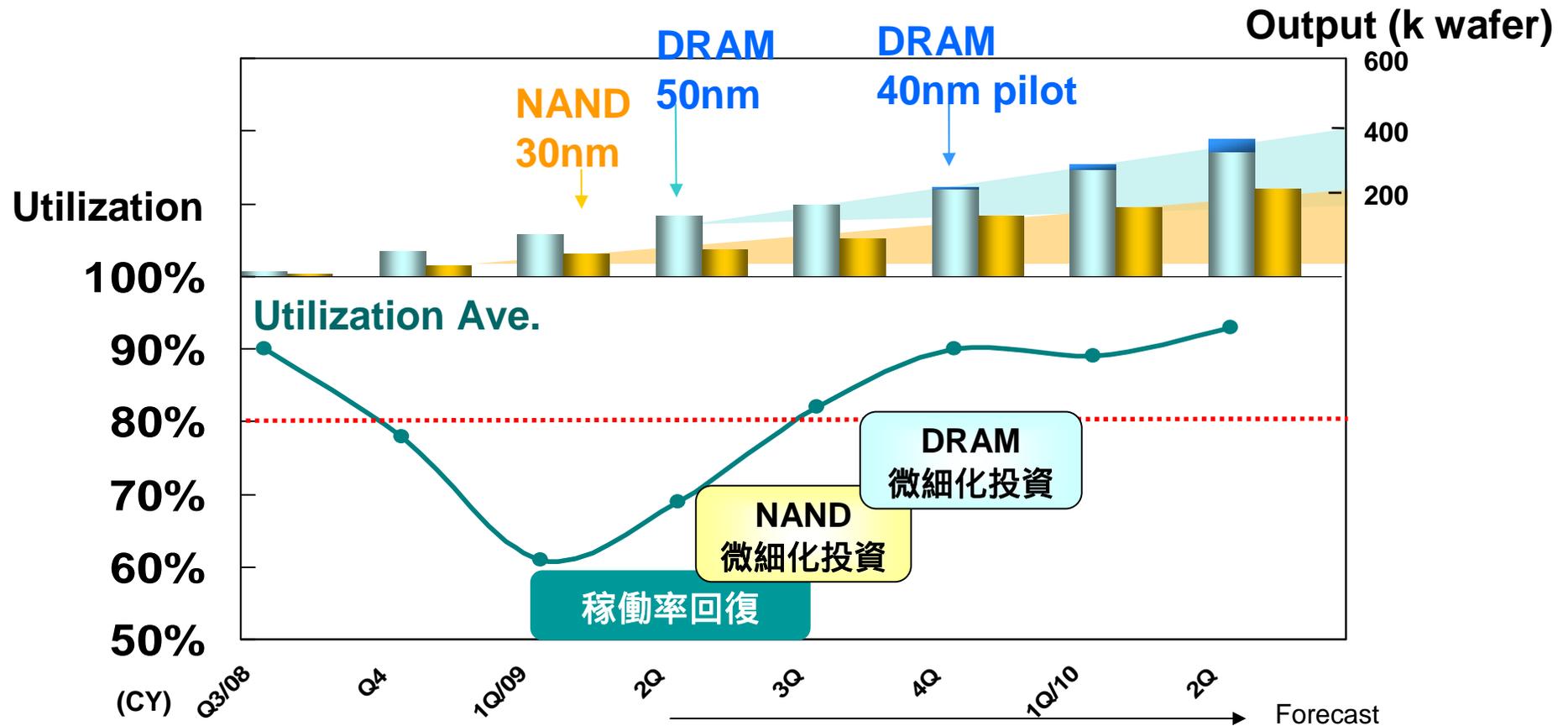
# メモリ需給バランス



NANDは09/Q2、DRAMも09/3Qに供給不足となり投資回復を予想



# 工場稼働率とメモリ微細化投資計画



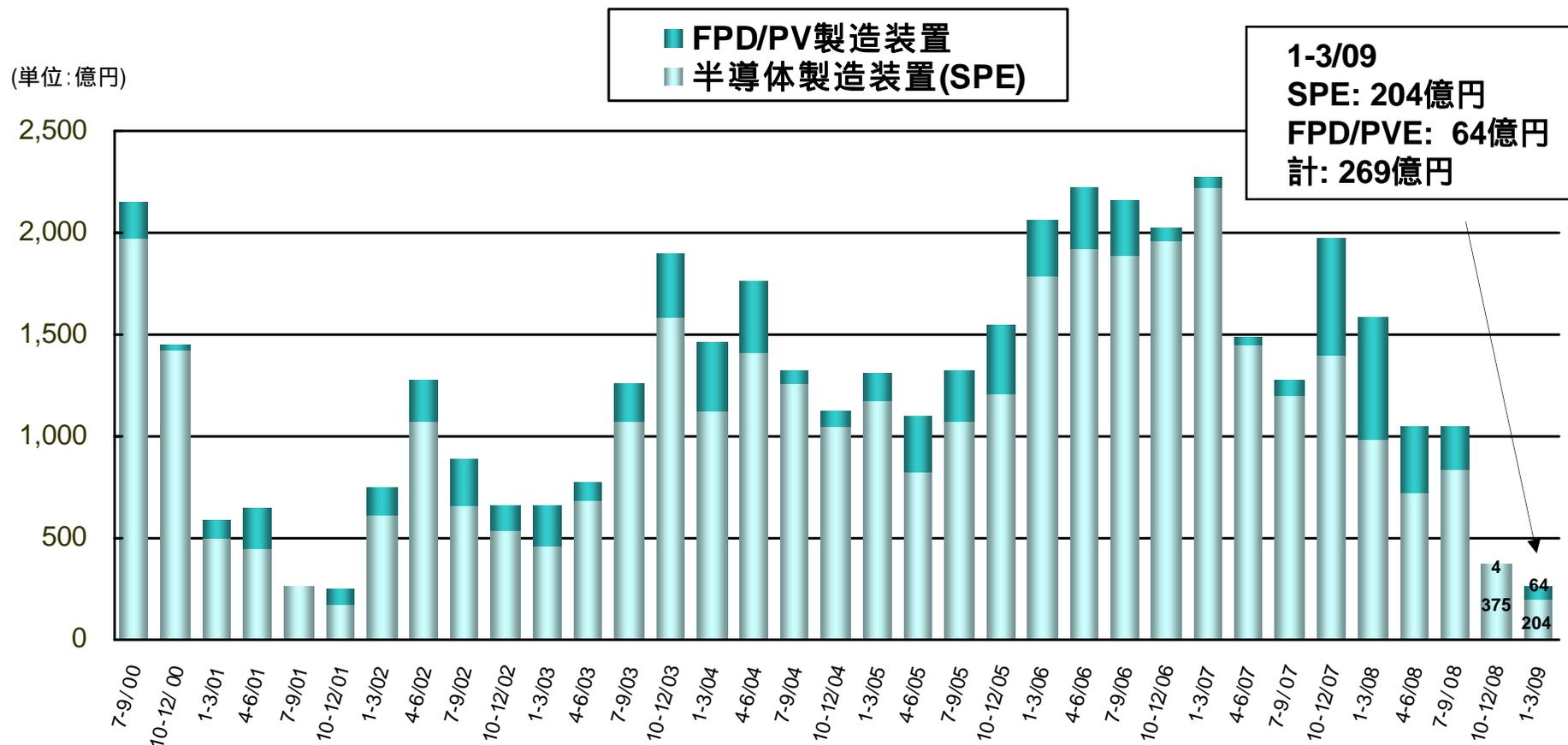
ファンドリ稼働率回復に続き、NAND、DRAM微細化投資が回復



# 2010年3月期 業績予想



# 四半期 SPE+FPD/PVE受注額



- 2005年10-12月期までは単独ベース、2006年1-3月期より連結ベース
- 単独ベースと連結ベースの主な差異: 連結ベースは海外現地法人におけるポストセールス受注を含む



# 2010年3月期 業績予想

(単位:億円)

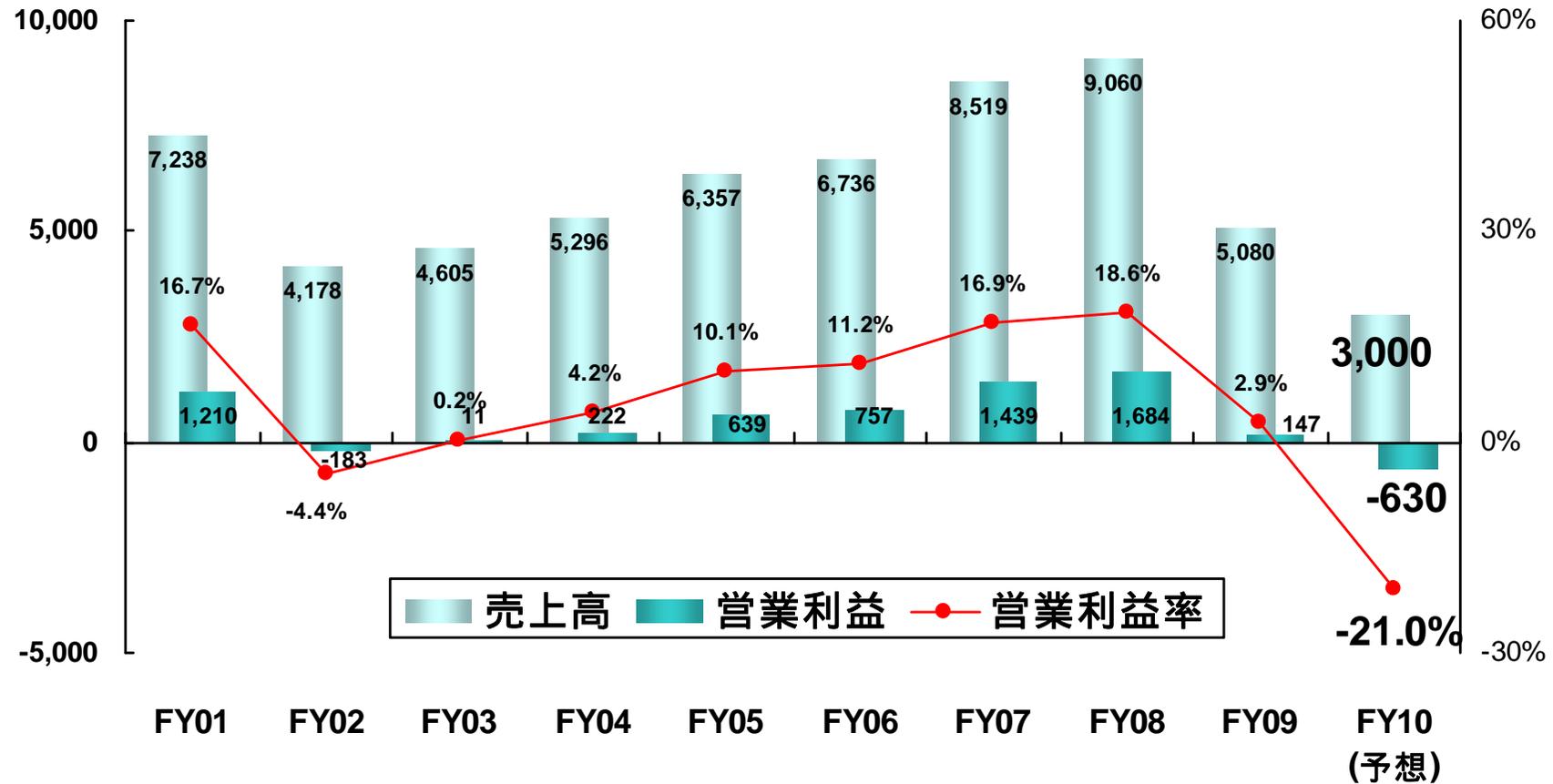
	2009年3月期		2010年3月期(予想)		
	通期	上期	下期	通期	対前年増減率
売上高	5,080	1,260	1,740	3,000	-41%
SPE	3,253	600	1,040	1,640	-50%
FPD/PVE	881	295	295	590	-33%
EC/CN	942	365	405	770	-18%
その他	3	0	0	0	-100%
営業利益	147 (2.9)	-420 (-33.3)	-210 (-12.1)	-630 (-21.0)	-
経常利益	205 (4.0)	-410 (-32.5)	-200 (-11.5)	-610 (-20.3)	-
税前利益	96 (1.9)	-410 (-32.5)	-200 (-11.5)	-610 (-20.3)	-
当期純利益	75 (1.5)	-260 (-20.6)	-120 (-6.9)	-380 (-12.7)	-
1株当り配当金 (円)	24	4	4	8	

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ( ): 利益率



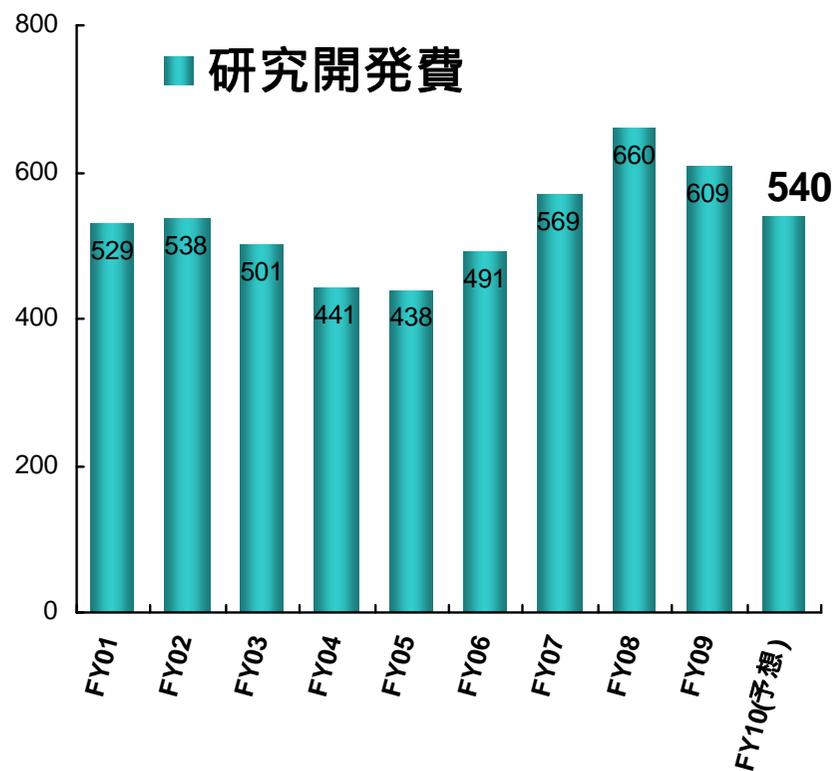
# 売上高・営業利益・営業利益率推移

(単位: 億円)

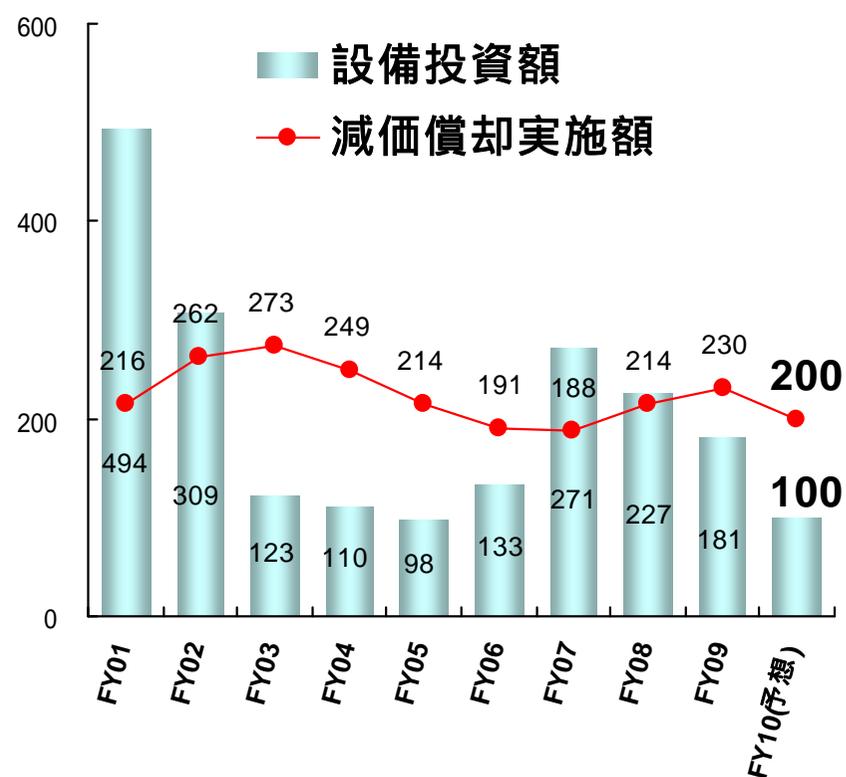


# 研究開発費・設備投資計画

(単位: 億円)



(単位: 億円)



研究開発費は選択的積極投資、設備投資は必要最低限



# 当期の重点施策

## 1. 総額300億円の固定費削減（2年累計700億円）

一般経費のさらなる削減  
設備投資の抑制  
外注人員削減効果

## 2. 既存ビジネスの最大化

既存製品分野を徹底的に強化

## 3. 成長のための研究開発投資を継続

高い成長が見込める分野への選択的積極投資

## 4. 市場変化への重点対応

ポストセールス事業の新骨格作り  
太陽電池事業の強化  
環境へのより高い配慮

中期的視野を持ちながら、短期的な諸問題に対応



# サマリー

1. SPE受注は回復基調を示しているものの、収益への反映は来年以降になるため、年度内の業績は厳しいと見る
2. 09年3月期に引き続き大幅なコスト削減を行い、損益分岐点を引き下げる
3. 市場変化はチャンスと捉えて、次の上昇期に市場成長を越える伸びを実現する
4. 成長に必要な研究開発、及び人への投資は強化する



